(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
4. Juli 2013 (04.07.2013)

WIPO | PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2013/097894 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
H01L 21/68 (2006.01) *H01L 21/67* (2006.01)
H01L 21/687 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2011/074166

(22) Internationales Anmeldedatum:
28. Dezember 2011 (28.12.2011)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(71) Anmelder *(für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US)*: **EV GROUP E. THALLNER GMBH** [AT/AT]; 1, DI Erich Thallner Straße, A-4782 St. Florian am Inn (AT).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder *(nur für US)*: **BURGGRAF, Jürgen** [AT/AT]; Wernsteinerstraße 34, A-4780 Schärding (AT).

(74) Anwälte: **SCHWEIGER, Johannes** et al.; 22, Turmstraße, 40878 Ratingen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart)*: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart)*: ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— *mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)*

(54) **Title**: METHOD AND DEVICE FOR BONDING OF SUBSTRATES

(54) **Bezeichnung** : VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM BONDEN VON SUBSTRATEN

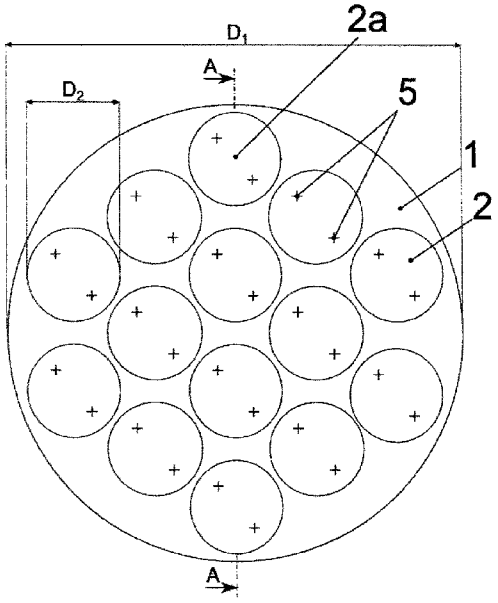


Fig. 2

(57) **Abstract**: The invention relates to a device for bonding first substrates (2) to second substrates (2'), said device having the following features: a receptacle for receiving a carrier substrate (1), a placement means for placing a plurality of first substrates (2) on a substrate side (1s) of the carrier substrate (1) facing away from the receptacle and a fixing means for fixing each of the first substrates (2) on the substrate side (1s) to at least one fixing section (2a) of each first substrate (2). The invention furthermore relates to a method for bonding first substrates (2) to second substrates (2'), having the following steps, particularly the following order: placing a plurality of first substrates (2) on a substrate side (1s) of a carrier substrate (1) received on a receptacle and fixing each of the first substrates (2) on the substrate side (1s) to at least one fixing section (2a) of each first substrate (2).

(57) **Zusammenfassung**: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Bonden von ersten Substraten (2) mit zweiten Substraten (2') mit folgenden Merkmalen: eine Aufnahme zur Aufnahme eines Trägersubstrats (1), einer Platzierungseinrichtung zur Platzierung mehrerer erster Substrate (2) auf einer von der Aufnahme abgewandten Substratseite (1s) des Trägersubstrats

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2013/097894 A1

(1) und einer Fixiereinrichtung zur Fixierung jedes der ersten Substrate (2) auf der Substratseite (1s) an mindestens einem Fixierabschnitt (2a) jedes ersten Substrats (2). Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zum Bonden von ersten Substraten (2) mit zweiten Substraten (2') mit folgenden Schritten, insbesondere folgendem Ablauf: Platzierung mehrerer erster Substrate (2) auf einer Substratseite (1s) eines auf eine Aufnahme aufgenommenen Trägersubstrats (1) und Fixierung jedes der ersten Substrate (2) auf der Substratseite (1s) an mindestens einem Fixierabschnitt (2a) jedes ersten Substrats (2).